

LM61

LM61 2.7V, SOT-23 or TO-92 Temperature Sensor



Literature Number: JAJ924

LM61


単一 2.7V 電源電圧動作 SOT-23 or TO-92 温度センサ

概要

LM61は、単一正電源で動作し、-30 ~ +100 の温度範囲を検出できる高精度温度センサICです。LM61の出力電圧は摂氏温度にリニアに比例 (+10mV/) しており、内部に600mVのDCオフセットを持っています。このオフセットにより、負電源を必要とせず負温度を読み取れます。LM61の理想的な出力電圧は、-30 ~ +100 の温度範囲で+300mV ~ +1600mVです。LM61は較正やドリミングのための外付け回路を必要とせず、室温で±2、-25 ~ +85 の全温度範囲で±3 の精度が得られます。LM61はウェハ・レベルでのドリミングや較正を行なうと、低コストと高精度が保証されます。

このLM61のリニアな出力、+600mVのオフセット、工場での較正により、単一電源動作で負温度の読み取りが要求されるアプリケーションでの回路の単純化が図れます。LM61の待機時消費電流は125µAであるため静止空気中での自己発熱が非常に少なく、0.2以下に抑えられています。LM61のシャットダウン機能は、LM61固有の低消費電力によって、様々なロジック・ゲートで直接電源を制御できるので、専用の制御端子を備えていなくても容易にシャットダウンができます。

特長

- +10mV/ のリニアな温度係数に較正された出力電圧
- 30 ~ +100 の動作温度範囲
- リモート・アプリケーションに最適
- UL規格に適合 

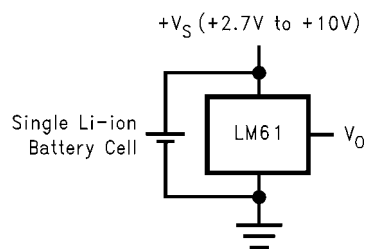
アプリケーション

- 携帯電話 / PHS
- 水晶発信器モジュール / デジタル TCXO
- コンピュータ
- 電源モジュール
- バッテリー・パック / 充電器
- FAX / プリンタ
- HVAC
- ディスク・ドライブ
- 液晶ディスプレイ

主な仕様

精度@ 25	± 2.0、± 3.0 (最大)
Cグレード精度 (-30 ~ +100)	± 4.0 (最大)
Bグレード精度 (-25 ~ +85)	± 3.0 (最大)
検出感度	+10mV/
動作規定温度範囲	+2.7V ~ +10V
待機時消費電流@ 25	125µA (最大)
非線形性	± 0.8 (最大)
出力インピーダンス	800 (最大)

代表的なアプリケーション

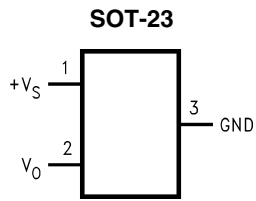


$$V_O = (+10 \text{ mV/} \times T) + 600 \text{ mV}$$

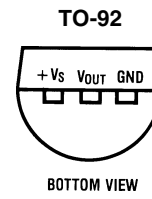
Temperature (T)	Typical V _O
+100°C	+1600 mV
+85°C	+1450 mV
+25°C	+850 mV
0°C	+600 mV
-25°C	+350 mV
-30°C	+300 mV

FIGURE 1. Full-Range Centigrade Temperature Sensor (-30 ~ +100) Operating from a Single Li-Ion Battery Cell

ピン配置図



Top View
See NS Package Number mf03a



See NS Package Number Z03A

製品情報

Order Number	Device Top Mark	Supplied In	Accuracy Over Specified Temperature Range (°C)	Specified Temperature Range	Package Type
LM61BIM3	T1B	1000 Units on Tape and Reel	± 3	-25°C to +85°C	SOT-23
LM61BIM3X	T1B	3000 Units on Tape and Reel			
LM61CIM3	T1C	1000 Units on Tape and Reel	± 4	-30°C to +100°C	
LM61CIM3X	T1C	3000 Units on Tape and Reel			
LM61BIZ	LM61BIZ	Bulk	± 3	-25°C to +85°C	TO-92
LM61CIZ	LM61CIZ	Bulk	± 4	-30°C to +100°C	

絶対最大定格 (Note 1)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
 関連する電氣的信頼性試験方法の規格を参照ください。

電源電圧	+ 12V ~ - 0.2V
出力電圧	(+ V _S + 0.6V) ~ - 0.6V
出力電流	10mA
各端子の入力電流 (Note 2)	5mA
保存温度範囲	- 65 ~ + 150
最大接合部温度 (T _{JMAX})	+ 125
ESD 耐性 (Note 3)	
人体モデル	2500V
マシン・モデル	250V

動作定格 (Note 1)

温度範囲	T _{MIN}	T _A	T _{MAX}
LM61C	- 30	~ +	100
LM61B	- 25	~ +	85
定格電源電圧範囲 (+ V _S)	+ 2.7V ~ + 10V		
熱抵抗 (J _A)(Note 5)			
SOT-23	450		/W
TO-92	180		/W

ハンダ付けのプロセスは、National Semiconductor's Reflow Temperature Profile 規格に準拠してください。
<http://www.national.com/JPN/packaging> をご覧ください (Note 4)。

電氣的特性

特記のない限り、以下の仕様は + V_S = + 3.0V_{DC} に対して適用されます。太文字表記のリミット値は T_A = T_J = T_{MIN} ~ T_{MAX} になつて適用され、その他のすべてのリミット値は T_A = T_J = 25 に対して適用されます。

Parameter	Conditions	Typical (Note 6)	LM61B	LM61C	Units (Limit)
			Limits (Note 7)	Limits (Note 7)	
Accuracy (Note 8)			±2.0	±3.0	°C (max)
			±3.0	±4.0	°C (max)
Output Voltage at 0°C		+600			mV
Nonlinearity (Note 9)			±0.6	±0.8	°C (max)
Sensor Gain (Average Slope)		+10	+9.7	+9.6	mV/°C (min)
			+10.3	+10.4	mV/°C (max)
Output Impedance	+3.0V ≤ +V _S ≤ +10V -30°C ≤ T _A ≤ +85°C, +V _S = +2.7V +85°C ≤ T _A ≤ +100°C, +V _S = +2.7V		0.8	0.8	kΩ (max)
			2.3	2.3	kΩ (max)
			5	5	kΩ (max)
Line Regulation (Note 10)	+3.0V ≤ +V _S ≤ +10V +2.7V ≤ +V _S ≤ +3.3V		±0.7	±0.7	mV/V (max)
			±5.7	±5.7	mV (max)
Quiescent Current	+2.7V ≤ +V _S ≤ +10V	82	125	125	μA (max)
			155	155	μA (max)
Change of Quiescent Current	+2.7V ≤ +V _S ≤ +10V	±5			μA
Temperature Coefficient of Quiescent Current		0.2			μA/°C
Long Term Stability (Note 11)	T _J = T _{MAX} = +100°C, for 1000 hours	±0.2			°C

Note 1: 「絶対最大定格」とは、IC に破壊が発生する可能性があるリミット値をいいます。「動作定格」とはデバイスが機能する条件を示しますが、特定の性能リミット値を示すものではありません。保証された仕様、試験条件については「電氣的特性」を参照してください。保証された仕様は「電氣的特性」に記載されている試験条件においてのみ適用されます。デバイスが記載の試験条件下で動作しない場合、いくつかの性能特性が低下することがあります。

Note 2: いずれかの端子で入力電圧 (V_I) が電源電圧を超えた場合 (V_I < GND または V_I > +V_S)、その端子の入力電流を 5mA 以下に制限しなければなりません。

Note 3: 人体モデルの場合、100pF のコンデンサから直列抵抗 1.5k を通して各端子に放電させます。マシン・モデルの場合は、200pF のコンデンサから直接各端子に放電させます。

Note 4: リフロー時の温度特性は、そのパッケージが鉛フリーかどうかによって異なります。

Note 5: 接合部・周囲温度間熱抵抗 (J_A) は静止空気中でヒートシンクなしの条件で規定されています。

Note 6: 代表値 (Typical) は、T_J = T_A = + 25 で得られる最も標準的な数値です。

Note 7: リミット値はナショナル・セミコンダクター社の平均出荷品質レベル AOQL に基づき保証されます。

Note 8: 精度は、特定の電圧、電流、温度 (で示される) 条件において出力電圧とデバイスのケース温度と (+ 10mV × デバイスのケース温度) 間の誤差として定義されます。

Note 9: 非線形性はデバイスの定格温度範囲で、理想直線に対する「出力電圧 vs 温度曲線」の偏差として定義されます。

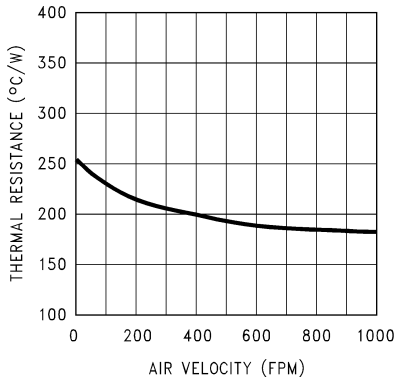
Note 10: レギュレーションは、低デューティ・サイクルを用いたパルステストにより、一定の接合部温度で測定したものです。温度上昇の影響による出力電圧変動は、内部消費電力と熱抵抗の積で計算されます。

Note 11: 高精度な回路で、経年変化に対して最大限の安定度を得るためには、デバイスを温めてエージングし、かつ / または long-term life test を始める前に少なくとも 46 時間の温度サイクルにかけることにより、最高の結果が得られます。これは特に、表面実装製品をウェーブ・ソルダリングする場合に適用されます。ほとんどのドリフトは、高温での最初の 1000 時間で生じます。1000 時間後のドリフトが、最初の 1000 時間のドリフトと同じ割合で続くことはありません。

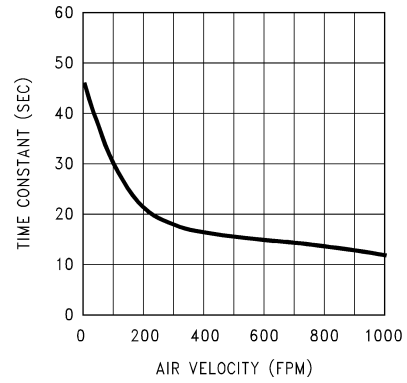
代表的な性能特性

以下の特性曲線は、Figure 2 に示すような銅箔プリント回路基板に LM61 を実装して測定したものです。

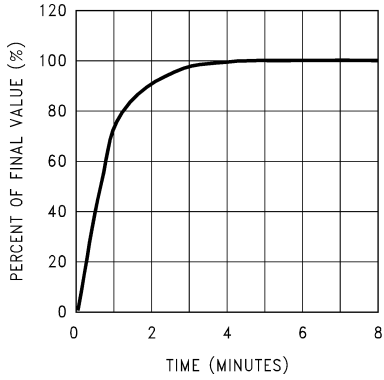
**Thermal Resistance
Junction to Air**



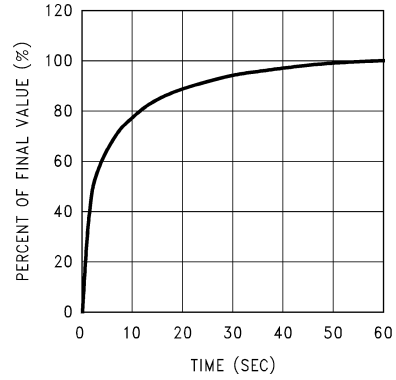
Thermal Time Constant



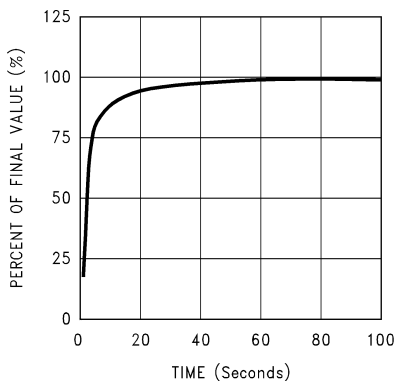
**Thermal Response in
Still Air with Heat Sink**



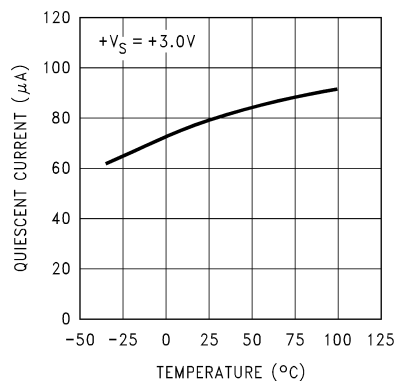
**Thermal Response
in Stirred Oil Bath
with Heat Sink**



**Thermal Response in Still
Air without a Heat Sink**



**Quiescent Current
vs. Temperature**



代表的な性能特性 (つづき)

以下の特性曲線は、Figure 2 に示すような銅箔プリント回路基板に LM61 を実装して測定したものです。

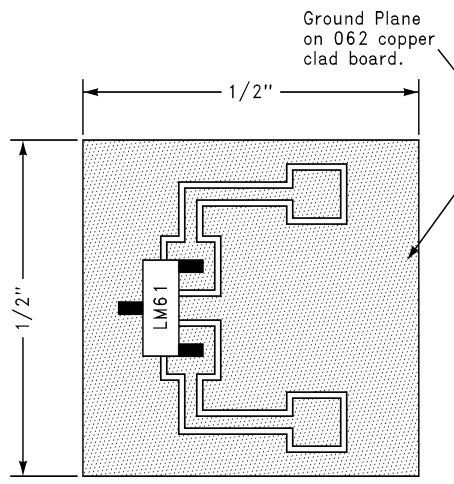
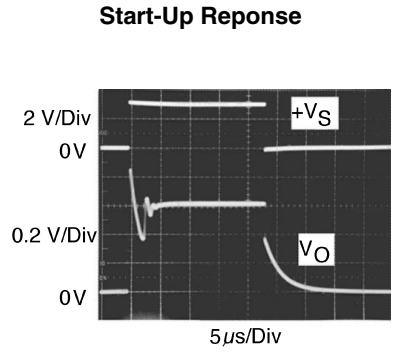
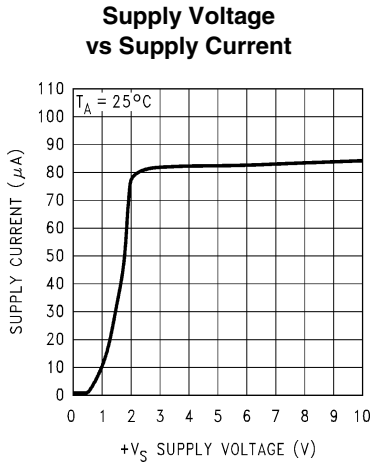
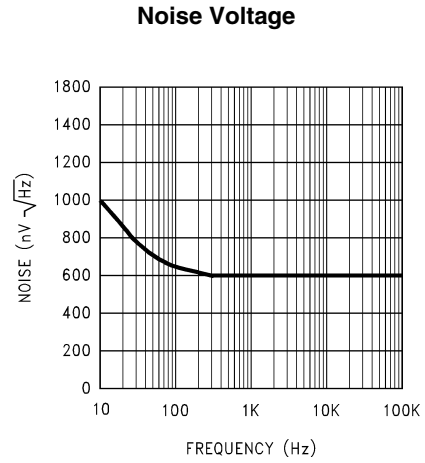
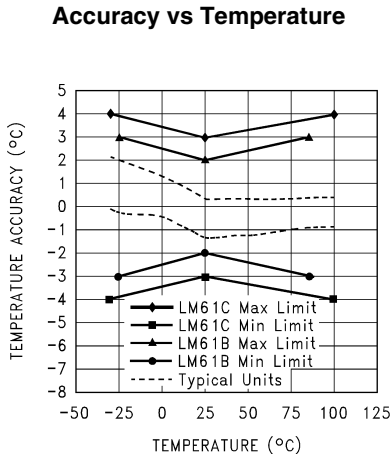


FIGURE 2. Printed Circuit Board Used for Heat Sink to Generate All Curves.
1/2" Square Printed Circuit Board with 2 oz. Copper Foil or Similar.

1.0 実装

LM61 は他の温度センサ IC と同じように容易に使用できます。デバイス表面に接着やセメント付けが可能で、LM61 自身の温度は表面温度の約 0.2 以内です。

この LM61 の性能は周囲温度が表面温度とほぼ同じ時に適用され、周囲温度とデバイスの表面温度との温度差が大きい場合は、LM61 のダイの実際の温度は、デバイスの表面温度と周囲温度との中間値になります。

熱伝導率を最適化するために、LM61 のダイの裏面を直接 GND 端子に取り付けています。LM61 に至る各ランドパターンはプリント基板の一部であり、温度測定の対象になります。ただし、これらのプリント回路基板のランドパターンによって、LM61 の所望の温度が遷移することはありません。

別の方法として、LM61 をシールドエンド・メタル・チューブの内部に実装し、バスに浸したり、タンクの細い穴にねじ込むことができます。LM61 およびその配線と回路は、一般の IC と同様にリー

クや腐食を防止するために、プリント基板のコーティング、ワニス、HUMISEAL などのエポキシ塗布や侵漬がよく使用されます。

接合部 - 周囲温度間熱抵抗は、デバイスの消費電力による接合部温度の上昇を計算するのに使われるパラメータです。LM61 に関して、ダイの温度上昇を計算するのに使われる等式は以下に示す通りです。

$$T_J = T_A + \theta_{JA} [(+V_S I_Q) + (+V_S - V_O) I_L]$$

I_Q は待機時消費電流、 I_L は出力負荷電流です。LM61 の接合部温度が実際に測定される温度なので、LM61 自身がドライブするのに必要な負荷電流は最小限に抑えるように注意してください。

Figure 3 に示される表は、3.3V の電源で負荷のない場合の LM61 のダイの温度上昇と異なった条件下での熱抵抗をまとめたものです。

	SOT-23*		SOT-23**		TO-92*		TO-92***	
	θ_{JA} (°C/W)	$T_J - T_A$ (°C)	θ_{JA} (°C/W)	$T_J - T_A$ (°C)	θ_{JA} (°C/W)	$T_J - T_A$ (°C)	θ_{JA} (°C/W)	$T_J - T_A$ (°C)
Still air	450	0.26	260	0.13	180	0.09	140	0.07
Moving air			180	0.09	90	0.05	70	0.03

* デバイスを 30 番ゲージ線にハンダ付けします。

** 使用したヒートシンクは、1/2 インチ平方の 2 オンス銅箔プリント基板にデバイスを実装したもの (Figure 2 参照)。

*** 2 オンスの銅箔または同等品でパターンニングした 1/16 インチ厚のプリント基板の 1 平方インチのパターン部にデバイスを接着してリードをハンダ付けしたものです。

FIGURE 3. Temperature Rise of LM61 Due to Self-Heating and Thermal Resistance (θ_{JA})

2.0 容量性負荷

LM61 は容量性負荷のドライブ能力が非常に優れています。

Figure 4 に示すように特別な処理をしなくても、LM61 はいかなる容量性負荷もドライブできます。LM61 は、最大値 5k の出力インピーダンスを持っています。特にノイズの多い環境下では、ノイズの介入を最小限に抑えるために何らかのフィルタリングを施す必要があります。Figure 5 に示すように 0.1 μ F のコンデンサを V_S と GND 端子との間に用い、電源電圧のバイパスを行なうことを推奨します。また、ノイズの多い環境下では出力端子と GND 端子の間にコンデンサを挿入する必要があります。5k の出力インピーダンスに対して 1 μ F のコンデンサを使用すると、32Hz のローパスフィルタを構成します。この場合、LM61 の熱時定数は RC で構成される時定数 5ms よりはるかに遅いので、LM61 の応答時間にはまったく影響しません。より大きなコンデンサを用いると、LM61 の応答時間が増大します。

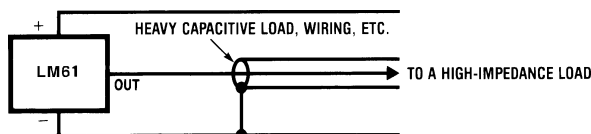


FIGURE 4. LM61 No Decoupling Required for Capacitive Load

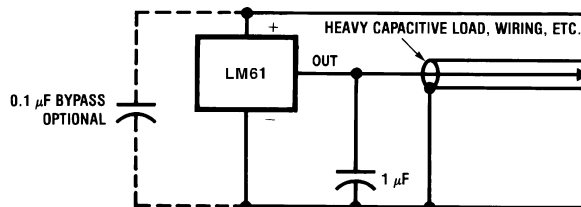


FIGURE 5. LM61 with Filter for Noisy Environment

2.0 容量性負荷装 (つづき)

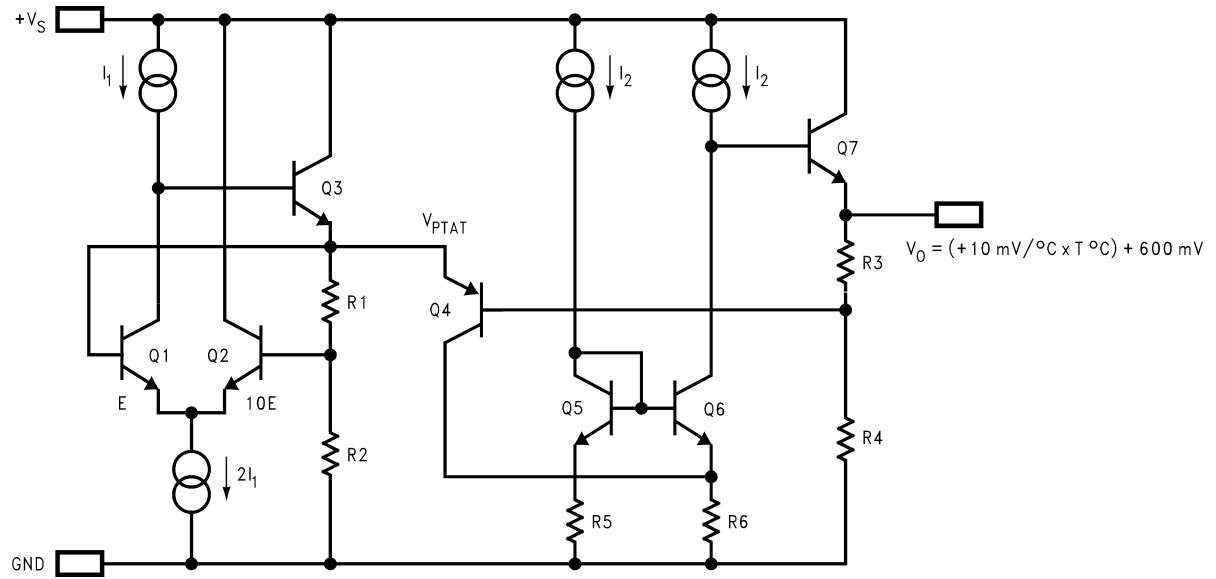
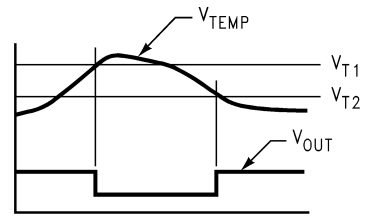
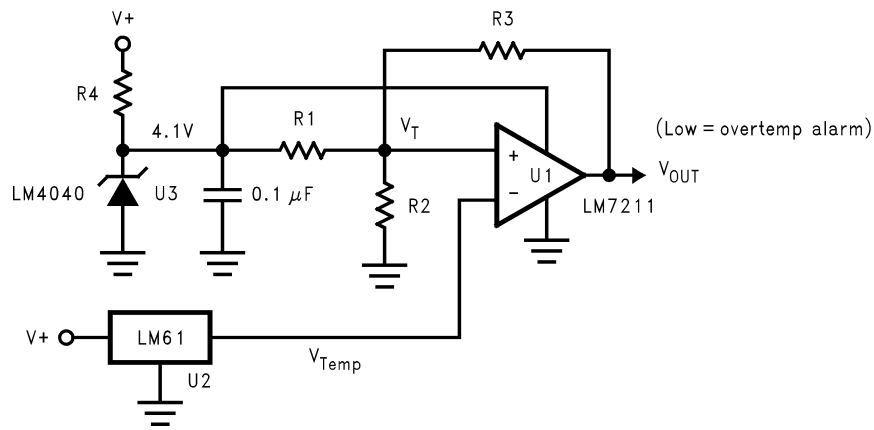


FIGURE 6. Simplified Schematic

3.0 アプリケーション回路例



$$V_{T1} = \frac{(4.1V)R2}{R2 + R1 \parallel R3}$$

$$V_{T2} = \frac{(4.1V)R2}{R2 \parallel R3 + R1}$$

$$V_{T1} = \frac{(4.1V) R2}{R2 + R1 \parallel R3}$$

$$V_{T2} = \frac{(4.1V) R2}{R2 \parallel R3 + R1}$$

FIGURE 7. Centigrade Thermostat

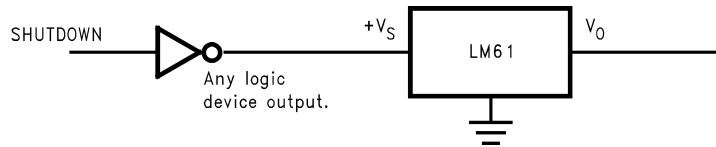
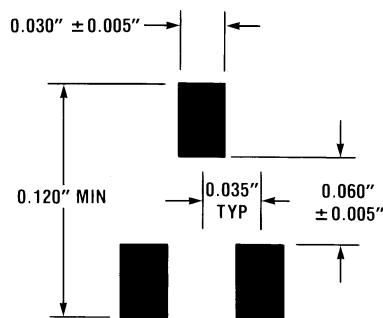
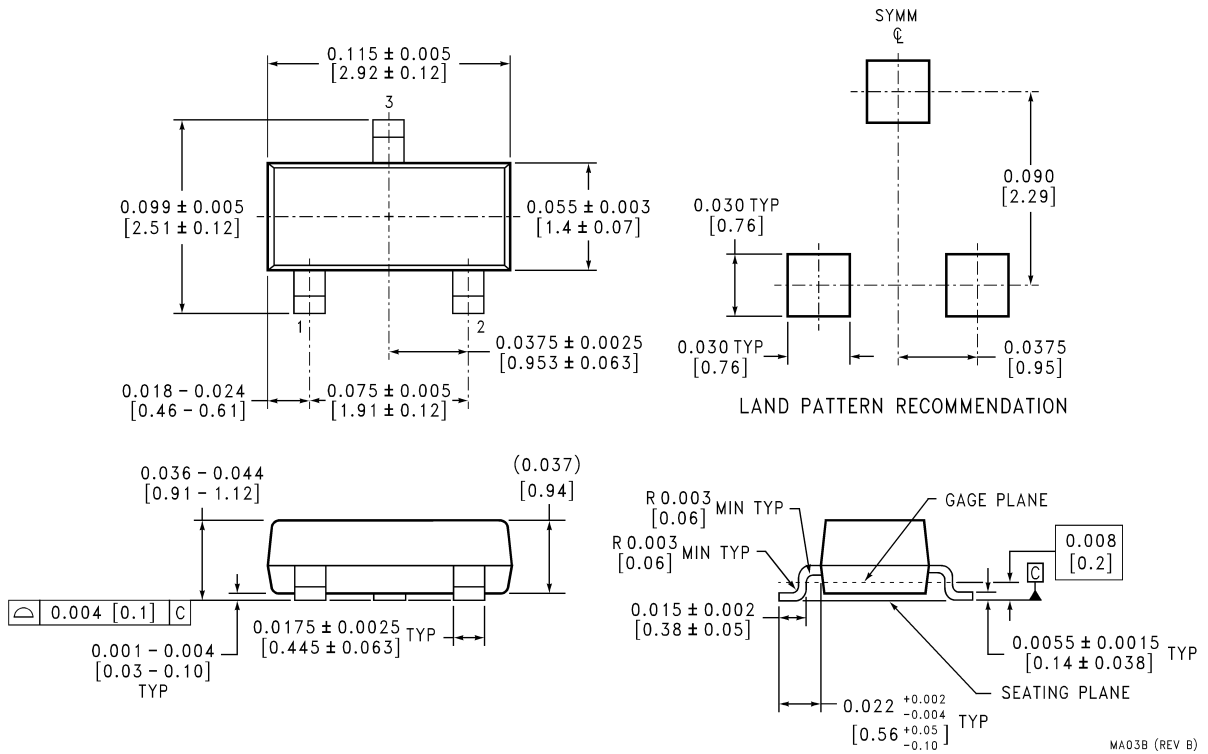


FIGURE 8. Conserving Power Dissipation with Shutdown

4.0 SOT-23 パッケージの推奨実装パッド



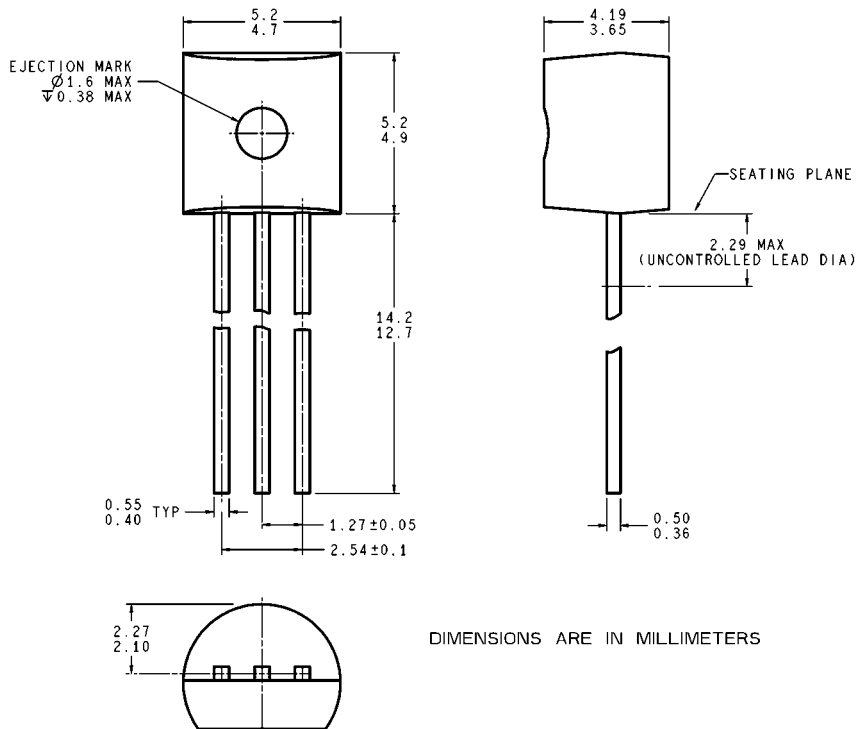
外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters)



SOT-23 Molded Small Outline Transistor Package (M3)
Order Number LM61BIM3, LM61BIM3X, LM61CIM3, or LM61CIM3X
NS Package Number mf03a

MA03B (REV B)

外形寸法図 単位は millimeters (つぎ)



Z03A (Rev G)

TO-92 Plastic Package (Z)
Order Number LM61BIZ or LM61CIZ
NS Package Number Z03A

このドキュメントの内容はナショナル セミコンダクター社製品の関連情報として提供されます。ナショナル セミコンダクター社は、この発行物の内容の正確性または完全性について、いかなる表明または保証もいたしません。また、仕様と製品説明を予告なく変更する権利を有します。このドキュメントはいかなる知的財産権に対するライセンスも、明示的、黙示的、禁反言による惹起、またはその他を問わず、付与するものではありません。

試験や品質管理は、ナショナル セミコンダクター社が自社の製品保証を維持するために必要と考える範囲に用いられます。政府が課す要件によって指定される場合を除き、各製品のすべてのパラメータの試験を必ずしも実施するわけではありません。ナショナル セミコンダクター社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務は負いかねます。ナショナル セミコンダクター社の部品を使用した製品および製品適用の責任は購入者にあります。ナショナル セミコンダクター社の製品を用いたいかなる製品の使用または供給に先立ち、購入者は、適切な設計、試験、および動作上の安全手段を講じなければなりません。

それら製品の販売に関するナショナル セミコンダクター社との取引条件で規定される場合を除き、ナショナル セミコンダクター社は一切の義務を負わないものとし、また、ナショナル セミコンダクター社の製品の販売が使用、またはその両方に関連する特定目的への適合性、商品の機能性、ないしは特許、著作権、または他の知的財産権の侵害に関連した義務または保証を含むいかなる表明または黙示的保証も行いません。

生命維持装置への使用について

ナショナル セミコンダクター社の製品は、ナショナル セミコンダクター社の最高経営責任者 (CEO) および法務部門 (GENERAL COUNSEL) の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用することは認められていません。

ここで、生命維持装置またはシステムとは (a) 体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b) 生命を維持あるいは支持するものをいい、ラベルにより表示される使用方法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与えると予想されるものをいいます。重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいいます。

National Semiconductor とナショナル セミコンダクターのロゴはナショナル セミコンダクター コーポレーションの登録商標です。その他のブランドや製品名は各権利所有者の商標または登録商標です。

Copyright © 2005 National Semiconductor Corporation
製品の最新情報については www.national.com をご覧ください。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社

本社 / 〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料 (日本語 / 英語) はホームページより入手可能です。

www.national.com/jpn/

ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（以下TIJといいます）及びTexas Instruments Incorporated（TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIといいます）は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかをご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間取引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定される危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合わせ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明もしていません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えたり、保証もしくは是認するということを意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付けられた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション（例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの）に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されていません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスチック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計されていませんし、また使用されることを意図されていません。但し、TIがISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2011, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

1. 静電気

- 素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。
- 弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。
- マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。
- 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

2. 温・湿度環境

- 温度：0～40℃、相対湿度：40～85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。（但し、結露しないこと。）

- 直射日光が当たる状態で保管・輸送しないこと。
3. 防湿梱包
 - 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。
 4. 機械的衝撃
 - 梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。
 5. 熱衝撃
 - はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。）
 6. 汚染
 - はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環境で保管・輸送しないこと。
 - はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。）

以上